

PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC /MCTI Nº 12, DE 29 DE MAIO DE 2023

Estabelece o Processo Produtivo Básico - PPB para o produto **TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA TRIAGEM PRÉ-AMBULATORIAL**, industrializado na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, art. 4º e nos arts. 11 a 18 do Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, e considerando o que consta no processo nº 19687.110177/2022-93, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º Fica estabelecido para o produto **TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA TRIAGEM PRÉ-AMBULATORIAL**, industrializado na Zona Franca de Manaus, o seguinte Processo Produtivo Básico composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas nas tabelas constantes dos Anexos I e II desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, de acordo com os dispostos nos Anexo I e II, sendo que a empresa deverá acumular a pontuação mínima por ano-calendário, dependendo do enquadramento do produto, conforme abaixo:

I - terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue e temperatura corporal: 797 (setecentos e noventa e sete) pontos; e

II - terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: eletrocardiograma, pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue, peso, altura e temperatura corporal: 765 (setecentos e sessenta e cinco) pontos.

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta Portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta Portaria deverá ser aplicado, na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização com fruição do benefício fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos os tributos incidentes nesta operação.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.



GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO I

Terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue e temperatura corporal

| Etapa | Descrição da Etapa Produtiva | Pontuação Total |
|-------|--|-----------------|
| I | Projeto de desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021. | 80 |
| II | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido adicionalmente em P&D, limitado a um máximo de 60 pontos. | 60 |
| III | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central (CPU). | 20 |
| IV | Processo de pintura eletrostática do gabinete. | 110 |
| V | Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do gabinete do terminal e suportes: impressora, oxímetro, medidor de pressão não invasiva, termômetro, leitor de cartão magnético, leitor de código 2D, monitor (com tela sensível ao toque "touch screen") e apoio para antebraço. | 385 |
| VI | Montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU (Central Process Unit). | 86 |
| VII | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central da impressora, montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes, exceto da cabeça de impressão térmica, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas. | 50 |
| VIII | Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos da unidade de saída por vídeo (monitor) com tela sensível ao toque ("touch screen"). | 61 |
| IX | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação de energia ou módulo de bateria. | 49 |
| X | Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU (Central Process Unit). | 80 |
| XI | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM. | 59 |
| XII | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive (SSD) ou on board. | 61 |
| XIII | Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto. | 50 |
| XIV | Testes. | 10 |
| TOTAL | | 1.161 |
| META | | 797 |

ANEXO II

Terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: eletrocardiograma, pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue, peso, altura e temperatura corporal

| Etapa | Descrição da Etapa Produtiva | Pontuação Total |
|-------|--|-----------------|
| I | Projeto de desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021. | 80 |
| II | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido adicionalmente em P&D, limitado a um máximo de 60 pontos. | 60 |



| | | |
|-------|--|-------|
| OIII | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central (CPU). | 20 |
| IV | Processo de pintura eletrostática do gabinete. | 60 |
| V | Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do gabinete do terminal e suportes: impressora, oxímetro, medidor de pressão não invasiva, termômetro, leitor de cartão magnético, leitor de código 2D, monitor (com tela sensível ao toque "touch screen") e apoio para antebraço. | 180 |
| VI | Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do estadiômetro, balança e ECG. | 82 |
| VII | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso e montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes, do módulo de controle de sensores. | 139 |
| VIII | Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas do monitor multiparamétrico. | 136 |
| IX | Integração das placas de circuitos impressos, partes elétricas e mecânicas da balança. | 10 |
| X | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso para controle funcional dos leds e estadiômetro. | 5 |
| XI | Montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU (Central Process Unit). | 81 |
| XII | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central da impressora, montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes, exceto da cabeça de impressão térmica, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas. | 40 |
| XIII | Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos da unidade de saída por vídeo (monitor) com tela sensível ao toque ("touch screen"). | 34 |
| XIV | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação de energia ou módulo de bateria. | 23 |
| XV | Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU (Central Process Unit). | 62 |
| XVI | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM. | 44 |
| XVII | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive (SSD) ou on board. | 45 |
| XVIII | Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto. | 50 |
| XIX | Testes. | 10 |
| TOTAL | | 1.161 |
| META | | 765 |

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

